

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		0.254	18+25	
2			18+25	

Basismaterialdicke:	0,29	+/- 10 %
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske:	0,40	+/- 10 %

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 150 µm
	Viapad-Ø	≥ 450 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm